

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/msi-mpg-gungnir-300p-airflow-p-49307.html>

MSI MPG Gungnir 300P Airflow

Cena brutto	683 zł
Cena netto	555 zł
Cena poprzednia	820 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	306-7G21P21-W57
Kod EAN	4711377103862
Producent	MSI

Opis produktu

MSI MPG Gungnir 300P Airflow

Kolor: **czarny**

Specyfikacja techniczna

- Możliwość montażu: **7 wentylatorów 120mm**
- Obsługiwane radiatory: **120 mm140 mm240 mm280 mm360 mm**
- Zainstalowane komponenty: **4 wentylatory 120 mm**
- Głębokość: **505 mm**
- Szerokość: **235 mm**
- Waga: **10.9 kg**
- Wysokość: **510 mm**
- Grupa produktowa: **Obudowy komputerowe MSI**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Kolor: **czarny**
- Konstrukcja obudowy: **wydzielona komora na zasilacz**
- Panel boczny: **przeźroczysty**
- Producent: **MSI**
- Standard: **ATXextended ATXmicro-ATXmini-ITX**
- Typ obudowy: **Midi Tower**
- Ilość kieszeni 2.5 wewn.: **6 szt.**
- Ilość kieszeni 3.5 wewn.: **2 szt.**
- Złącza na przednim panelu: **1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Typ-C)2 x USB 3.2 Gen 1audio**
- Dodatkowe cechy: **E-ATX do 280 mm x 305 mm**
- Model: **MSI MPG Gungnir 300**
- Nazwa producenta / importera: **MSIMSI Computer Europe BVEScience Park Eindhoven 57065692 ER Son Eindhoven HolandiaEmail: GPSR@msi.com**
- Maksymalna długość karty graficznej: **36 cm**
- Maksymalna wysokość chłodzenia: **17 cm**
- Standard zasilacza: **ATX**
- Wbudowany zasilacz: **brak w komplecie**

Odkryj obudowę, która redefiniuje standardy dla komputerów typu mid-tower, oferując doskonałe połączenie estetyki, funkcjonalności i wydajności. MSI MPG Gungnir 300P Airflow to konstrukcja stworzona z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, którzy cenią sobie nie tylko potężne komponenty, ale także optymalne warunki ich pracy. Jej wyrafinowany design, charakteryzujący się jednomilimetrowym, perforowanym panelem przednim, nie tylko zachwyca wyglądem, ale również stanowi klucz do niezrównanego przepływu powietrza. Wybierając ten model, zyskujesz solidną podstawę dla swojego systemu, gotową sprostać każdemu wyzwaniu.

Mistrzowski przepływ powietrza i chłodzenie

Ciesz się niezachwianą stabilnością i niskimi temperaturami nawet podczas intensywnych sesji gamingowych czy wymagających zadań. Obudowa MSI MPG Gungnir 300P Airflow została zaprojektowana z myślą o maksymalizacji przepływu powietrza, co jest kluczowe dla wydajności współczesnych komponentów. Perforowany panel przedni o grubości zaledwie 1 mm skutecznie filtruje kurz, jednocześnie umożliwiając swobodny dopływ świeżego powietrza. Dodatkowe otwory wentylacyjne na panelu bocznym i osłonie zasilacza gwarantują optymalną cyrkulację, zapobiegając gromadzeniu się ciepła i zapewniając komponentom idealne warunki pracy.

Intuicyjna konstrukcja dla bezproblemowej rozbudowy

Doświadcz łatwości montażu i rozbudowy, którą oferuje przemyślana konstrukcja obudowy MSI MPG Gungnir 300P Airflow. Dzięki wielokierunkowemu uchwytywi na kartę graficzną, możesz bez trudu dostosować jego położenie do rozmiaru i sposobu montażu Twojej karty, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Innowacyjne rozwiązania, takie jak wysuwane sanki montażowe na oraz wyjmowany wspornik na śledzie kart PCIe, znacznie ułatwiają aranżację wnętrza. Szybkie zatrzaski pozwalają błyskawicznie zmieniać konfigurację, zapewniając elastyczność i wygodę na każdym etapie budowy systemu.

Nieograniczone możliwości konfiguracji komponentów

Zyskaj pełną swobodę w doborze podzespołów, tworząc system idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Obudowa MSI MPG Gungnir 300P Airflow obsługuje szeroki zakres formatów płyt głównych, od kompaktowych Mini-, przez Micro- i ATX, aż po rozbudowane E-ATX o wymiarach do 280 x 305 mm. Przestronne wnętrze pomieści o długości do 360 mm i grubości 80 mm, a także coolery procesora o wysokości do 175 mm. Do dyspozycji masz również sześć dedykowanych doków na dyski SSD 2,5 cala oraz wyjmowany kosz na dwa dyski 2,5/3,5 cala, co zapewnia obfite miejsce na wszystkie dane.

Zaawansowane opcje chłodzenia cieczą dla entuzjastów

Podnieś wydajność swojego systemu na nowy poziom, wykorzystując zaawansowane możliwości chłodzenia cieczą. Obudowa MSI MPG Gungnir 300P Airflow umożliwia instalację aż dwóch radiatorów 360 mm, co jest idealne dla najbardziej wymagających konfiguracji z procesorami i kartami graficznymi o wysokim . Zarówno przód, jak i góra obudowy oferują imponujący 80-milimetrowy prześwit, pozwalając na montaż grubszych modeli radiatorów bez kompromisów. Niezależnie od tego, czy planujesz system AIO, czy niestandardową pętlę chłodzenia cieczą, ten model dostarcza elastyczności, której potrzebujesz.

Błyskawiczna łączność na wyciągnięcie ręki

Korzystaj z najnowszych technologii transferu danych dzięki wygodnie umieszczonym złączom na górnym panelu obudowy. Model MSI MPG Gungnir 300P Airflow wyposażono w port USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, który w połączeniu z kompatybilnymi umożliwia przesyłanie danych z oszałamiającą prędkością do 20 Gbit/s. Dodatkowo, do dyspozycji masz dwa porty USB 3.2 Gen 1 oraz złącza audio, co zapewnia łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych peryferiów i akcesoriów, zwiększając komfort codziennego użytkowania.

Obsługa do 10 wentylatorów

Obudowę przystosowano do optymalnego, wysokowydajnego przepływu powietrza. Fabrycznie wyposażona jest w trzy 120-milimetrowe wentylatory ARGB zainstalowane na przednim, perforowanym panelu i w jeden wentylator ARGB 120 mm, który znajduje się z tyłu obudowy.

Ponadto, obudowa ta może pomieścić aż do dziesięciu, 120-milimetrowych wentylatorów (lub 7 x 140 mm i 3 x 120 mm), dzięki czemu można zmaksymalizować chłodzenie.

Możliwość montażu dwóch radiatorów 360 mm

W obudowie można zainstalować do dwóch, 360-milimetrowych radiatorów systemu chłodzenia cieczą. Ponadto, przód i góra obudowy oferują aż 80-milimetrowy prześwit, co pozwala na łatwy montaż grubszych modeli radiatorów. Oprócz możliwości instalacji różnych modeli radiatorów, w obudowie zainstalować można praktycznie dowolny system chłodzenia cieczą AIO lub niestandardową pętlę chłodzenia cieczą z więcej niż jednym radiatorem.

Złącza We/Wy dostępne na górnym panelu

W wypadku kompatybilnych płyt głównych, górny panel złączy We/Wy oferuje port USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, dzięki któremu można przesyłać dane z prędkością dochodząca do 20 Gbit/s.

MSI MPG Gungnir 300P Airflow